AVAILABLE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-201232

(43) Date of publication of application: 19.07.2002

(51)Int.CI.

C08F220/28

CO8J 3/14 G03F 7/039

(21)Application number: 2001-186493

(71)Applicant : DAICEL CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

20.06.2001

(72)Inventor: TSUTSUMI KIYOHARU

(30)Priority

Priority number : 2000329616

Priority date : 27.10.2000

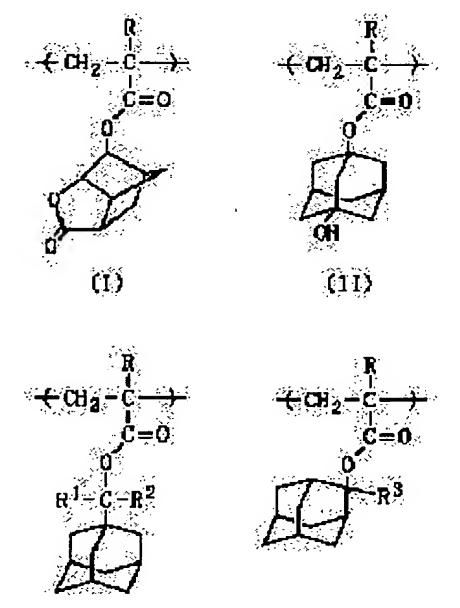
Priority country: JP

(54) POLYMER COMPOUND FOR PHOTORESIST AND RESIN COMPOSITION FOR **PHOTORESIST**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polymer compound for photoresist which is excellent in dry etching resistance, adhesion to substrates, and alkali solubility and exhibits a high solubility in propylene glycol monomethyl ether acetate(PGMEA).

SOLUTION: This polymer compound contains (A) 22-40 mol% monomer units represented by formula (I), (B) 20-38 mol% monomer units represented by formula (II), and (C) 22-58 mol% at least one kind of monomer units selected from monomer units represented by formulae (IIIa) and (IIIb). In those formulae, R is H or methyl; and R1, R2, and R3 are each independently a 1-3C alkyl.



(IIII)

(1116)

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.08.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-201232 (P2002-201232A)

(43)公開日 平成14年7月19日(2002.7.19)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコート*(参考)
C 0 8 F 220/28		C 0 8 F 220/28	2H025
C 0 8 J 3/14		C 0 8 J 3/14	4F070
G 0 3 F 7/039	601	G 0 3 F 7/039	601 4J100

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 8 頁)

(21)出願番号	特願2001-186493(P2001-186493)	(71)出願人 000002901
		ダイセル化学工業株式会社
(22)出願日	平成13年6月20日(2001.6.20)	大阪府堺市鉄砲町1番地
		(72)発明者 堤 聖晴
(31)優先権主張番号	特願2000-329616(P2000-329616)	兵庫県姫路市網干区新在家940
(32)優先日	平成12年10月27日(2000.10.27)	(74)代理人 100101362
(33)優先権主張国	日本 (JP)	弁理士 後藤 幸久
		Fターム(参考) 2H025 AA09 AA14 AB16 AC04 AC08
		. ADO3 BC86 BE00 BE10 BG00
		CB41 CB52 CC03 FA17
		4F070 AA32 DA22 DC11
	·	4J100 AL08P AL08Q AL08R AL08S
		BA03Q BC09Q BC09R BC09S
		BC53P CA05 CA06 JA38

(54) 【発明の名称】 フォトレジスト用高分子化合物及びフォトレジスト用樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 高いドライエッチング耐性、基板密着性及びアルカリ可溶性を示すと共に、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)に対して溶解性の高いフォトレジスト用高分子化合物を得る。

【解決手段】 フォトレジスト用高分子化合物は、

(A) 下記式(I) で表されるモノマーユニットを22~40モル%、(B) 下記式(II) で表されるモノマーユニットを20~38モル%、及び(C) 下記式(III a) 及び(IIIb) から選択された少なくとも1種のモノマーユニットを22~58モル%含む。

【化1】

(式中、Rは水素原子又はメチル基を示し、R'、R'、R'、R'は、それぞれ独立に、炭素数1~3のアルキル基を示す)

10

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)下記式(I)で表されるモノマーユニットを22~40モル%、(B)下記式(II)で表されるモノマーユニットを20~38モル%、及び(C)下記式(IIIa)及び(IIIb)から選択された少なくとも1種のモノマーユニットを22~58モル%含むフォトレジスト用高分子化合物。

【化1】

(式中、Rは水素原子又はメチル基を示し、R¹、R²、R²は、それぞれ独立に、炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基を示す)

【請求項2】 式 (IIIa) におけるR¹、R²が共にメチ 30 ル基である請求項1記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項3】 式(IIIb) におけるR³がメチル基又は エチル基である請求項1記載のフォトレジスト用高分子 化合物。

【請求項4】 モノマーユニット(A)、モノマーユニット(B)及びモノマーユニット(C)の合計含有量がポリマーを構成する全モノマーユニットの90モル%以上である請求項1記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項5】 (a)下記式(1)で表される(メタ)アクリル酸エステルを22~40モル%、(b)下記式(2)で表される(メタ)アクリル酸エステルを20~38モル%、及び(c)下記式(3a)及び(3b)から選択された少なくとも1種の(メタ)アクリル酸エステルを22~58モル%含む単量体混合物を共重合して得られるフォトレジスト用高分子化合物。

【化2】

$$CH_2 = C$$

$$C = 0$$

$$R^1 - C - R^2$$

$$(3a)$$

$$CH_2 = C$$

$$C = 0$$

$$R^3$$

$$(3b)$$

(式中、Rは水素原子又はメチル基を示し、R¹、R²、R³は、それぞれ独立に、炭素数1~3のアルキル基を20 示す)

【請求項6】 (a)、(b)及び(c)の3種の(メタ)アクリル酸エステルを含む単量体混合物を共重合し、生成したポリマーを含む溶液を有機溶媒中に添加することにより沈殿又は再沈殿して得られる請求項5記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項7】 沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒が、炭化水素、ハロゲン化炭化水素、ニトロ化合物、ニトリル、エーテル、ケトン、エステル、カーボネート、アルコール、カルボン酸又はこれらの溶媒を含む混合溶媒である請求項6記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項8】 沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒が少なくとも炭化水素を含む請求項6記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項9】 沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒のFedorsの方法による溶解度パラメーターの値が7.0(cal/cm³)¹/²~14.0(cal/cm³)¹/²[14.3MPa¹/²~28.6MPa¹/²]の範囲である請求項6記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項10】 請求項1~9の何れかの項に記載のフォトレジスト用高分子化合物と光酸発生剤とを少なくとも含むフォトレジスト用樹脂組成物。

【請求項11】 溶剤としてプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートを含む請求項10記載のフォトレジスト用樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

40

【発明の属する技術分野】本発明は半導体の微細加工な 50 どを行う際に用いるフォトレジスト用の高分子化合物

と、この高分子化合物を含有するフォトレジスト用樹脂 組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造工程で用いられるフォトレジ スト用樹脂は、基板密着性を示す部分と、露光によって 光酸発生剤から発生する酸により脱離してアルカリ現像 液に対して可溶になる部分が必要であるとともに、ドラ イエッチング耐性をも具備している必要がある。

【0003】従来、基板密着性を付与し、且つドライエ ッチング耐性を有する構造として、ラクトン環を含有す 10 る脂環式炭化水素骨格が知られている。また、酸脱離性 を付与し、且つドライエッチング耐性を有する構造とし て第3級炭素原子を含有する脂環式炭化水素骨格が提案 されている。従って、これらの2つの骨格を有する単量 体を共重合させれば、フォトレジスト用樹脂に必要な機 能が集積されたポリマーを得ることが可能である。特 に、ポリマーを構成するモノマーユニットの全部又は大 部分が脂環式骨格を有するような樹脂はドライエッチン グ耐性が高いので望ましい。

【0004】一方、レジスト用の溶剤として、毒性が低 20 い等の点からプロピレングリコールモノメチルエーテル アセテート(PGMEA)が一般的、標準的に使用され るようになってきた。

【0005】ところが、上記のポリマーを構成するモノ マーユニットの全部又は大部分が脂環式骨格を有するよ うな樹脂は、一般にプロピレングリコールモノメチルエ ーテルアセテート (PGMEA) に対する溶解性が低い ため、レジスト用樹脂として使用しにくいという難点が ある。また、モノマーや、オリゴマー等の低分子量物を 含むポリマーをフォトレジスト用樹脂として用いると、 微細なパターンを精度よく形成できない場合が生じる。 [0006]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は、高いドライエッチング耐性、基板密着性及びアルカ リ可溶性を示すと共に、プロピレングリコールモノメチ ルエーテルアセテート(PGMEA)に対して溶解性の 高いフォトレジスト用高分子化合物と、該高分子化合物 を含むフォトレジスト用樹脂組成物を提供することにあ る。

【0007】本発明の他の目的は、ボリマーを構成する モノマーユニットの全部又は大部分が脂環式骨格を有す るモノマーユニットであっても、プロピレングリコール モノメチルエーテルアセテート(PGMEA)に対して 溶解性の高いフォトレジスト用高分子化合物と、該高分 子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物を提供する ことにある。

【0008】本発明のさらに他の目的は、微細なバター ンを精度よく形成できるフォトレジスト用高分子化合物 と、該高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物 を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的 を達成するため鋭意検討した結果、脂環式骨格を有する 特定構造の3種のモノマーユニットを特定の割合で含む 樹脂は、高いドライエッチング耐性、基板密着性及びア ルカリ可溶性を有するだけでなく、前記モノマーユニッ トの何れもが脂環式骨格を含んでいるにもかかわらず、 プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート (PGMEA) に対して高い溶解性を示すことを見出 し、本発明を完成した。

【0010】すなわち、本発明は、(A)下記式(I) で表されるモノマーユニットを22~40モル%、

(B) 下記式 (II) で表されるモノマーユニットを20 ~38モル%、及び(C)下記式(IIIa)及び(IIIb) から選択された少なくとも1種のモノマーユニットを2 2~58モル%含むフォトレジスト用高分子化合物を提 供する。

【化3】

30

(式中、Rは水素原子又はメチル基を示し、R¹、R²、 R'は、それぞれ独立に、炭素数1~3のアルキル基を 示す)

前記式(IIIa)におけるR¹、R¹は共にメチル基である のが好ましい。また、式(IIIb) におけるR³は好まし くはメチル基又はエチル基である。前記フォトレジスト 用高分子化合物の好ましい態様では、モノマーユニット (A)、モノマーユニット(B)及びモノマーユニット (C)の合計含有量がポリマーを構成する全モノマーユ ニットの90モル%以上である。

【0011】本発明は、また、(a)下記式(1)で表 される (メタ) アクリル酸エステルを22~40モル %、(b)下記式(2)で表される(メタ)アクリル酸 50 エステルを20~38モル%、及び(c)下記式(3a)

(4)

及び(3b)から選択された少なくとも1種の(メタ)ア クリル酸エステルを22~58モル%含む単量体混合物 を共重合して得られるフォトレジスト用高分子化合物を 提供する。

【化4】

$$CH_2 = C$$

$$C = 0$$

$$R^1 - C - R^2$$

$$(3a)$$

$$CH_2 = C$$

$$R^3$$

$$(3b)$$

(式中、Rは水素原子又はメチル基を示し、 R^1 、 R^2 、 R^3 は、それぞれ独立に、炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基を示す)

【0012】このフォトレジスト用高分子化合物には、前記(a)、(b)及び(c)の3種の(メタ)アクリル酸エステルを含む単量体混合物を共重合し、生成したポリマーを含む溶液を有機溶媒中に添加することにより沈殿又は再沈殿して得られるフォトレジスト用高分子化 30合物が含まれる。

【0013】上記の沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒として、例えば、炭化水素、ハロゲン化炭化水素、ニトロ化合物、ニトリル、エーテル、ケトン、エステル、カーボネート、アルコール、カルボン酸又はこれらの溶媒を含む混合溶媒などを使用できる。また、上記の沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒は、少なくとも炭化水素を含むのが好ましい。また、上記の沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒のFedorsの方法による溶解度バラメーターの値は、例えば、7.0(cal/cm³)1/2~14.0(cal/cm³)1/2~14.0(cal/cm³)1/2~14.3MPa1/2~28.6MPa1/2〕の範囲であるのが好ましい。

【0014】本発明は、また、上記のフォトレジスト用 高分子化合物と光酸発生剤とを少なくとも含むフォトレジスト用樹脂組成物を提供する。このフォトレジスト用 樹脂組成物は、溶剤としてプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートを含んでいてもよい。

【0015】なお、本明細書では、「アクリル」と「メタクリル」とを「(メタ)アクリル」、「アクリロイ

ル」と「メタクリロイル」とを「(メタ)アクリロイル」等と総称する場合がある。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明のフォトレジスト用高分子 化合物は、ボリマー分子内に、前記式(I)で表される モノマーユニット(A)を22~40モル%、前記式 (II)で表されるモノマーユニット(B)を20~38 モル%、及び前記式(IIIa)及び(IIIb)から選択され た少なくとも1種のモノマーユニット(C)を22~5 10 8モル%含んでいる。

【0017】モノマーユニット(A)はラクトン環を有し、モノマーユニット(B)は環にヒドロキシル基を有することから、両ユニットは基板への密着性を高める密着性付与ユニットとして機能する。一方、モノマーユニット(C)は、エステル結合を構成する酸素原子が第3級炭素原子に結合していることから、酸によってアダマンタン骨格を含む部位が主鎖に結合したカルボン酸部から脱離して遊離のカルボキシル基を生成させるため、アルカリ現像時に可溶化するアルカリ可溶性ユニットとして機能する。また、モノマーユニット(A)、(B)及び(C)は、何れも脂環式骨格を有するため、これらのモノマーユニットで構成されているボリマーは、ドライエッチング耐性が著しく高い。

【0018】そして、モノマーユニット(A)、(B)及び(C)を上記の範囲で含有する高分子化合物は、前記モノマーユニットが何れも脂環式骨格を有しているにもかかわらず、レジスト用の溶剤として一般的に用いられるプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに対して溶解性が高いという極めて有利な特徴を有する。そのため、フォトレジスト用樹脂として好適に使用できる。なお、各モノマーユニットの割合が上記の範囲を外れる場合には、ポリマーのプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに対する溶解度が大きく低下する。

【0019】ポリマーを構成する全モノマーユニットの うち、前記各モノマーユニットの占める好ましい割合 は、モノマーユニット(A)が25~35モル%、モノ マーユニット(B)が25~35モル%、モノマーユニット(C)が30~50モル%程度である。

0 【0020】前記式(IIIa)及び(IIIb)中、R¹、R²、R³における炭素数1~3のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基が挙げられる。R¹、R²としては、特にメチル基が好ましく、R³としては、特にメチル基又はエチル基が好ましい。

【0021】本発明のフォトレジスト用高分子化合物は、前記のモノマーユニット(A)、(B)及び(C)のみで構成されていてもよく、他のモノマーユニットを含んでいてもよい。本発明の好ましい態様では、モノマ50 ーユニット(A)、(B)及び(C)の合計含有量がボ

リマーを構成する全モノマーユニットの90モル%以 上、より好ましくは95モル%以上、特に好ましくは9 8モル%以上(例えば100モル%)である。また、本 発明の他の好ましい態様では、アダマンタン骨格やノル ボルネン骨格に限らず、脂環式骨格を有するモノマーユ ニットを全モノマーユニットの90モル%以上含んでい る。これらの好ましい態様の髙分子化合物は、特にドラ

【0022】本発明では、高分子化合物の重量平均分子 量(Mw)は、例えば1,000~500,000、好 10 ロイルオキシー2-エチルアダマンタン、2-エチルー ましくは3,000~50,000、さらに好ましくは 5,000~20,000程度であり、分子量分布(M w/Mn)は、例えば1.5~3.5程度である。な お、前記Mnは数平均分子量(ポリスチレン換算)を示 す。

イエッチング耐性に優れる。

【0023】前記式(I)、(II)、(IIIa)、(III b)で表される各モノマーユニットは、それぞれ対応す る(メタ)アクリル酸エステルをコモノマーとして重合 に付すことにより形成できる。すなわち、本発明のフォ トレジスト用高分子化合物は、(a)前記式(1)で表 20 される(メタ)アクリル酸エステルを22~40モル %、(b)前記式(2)で表される(メタ)アクリル酸 エステルを20~38モル%、及び(c)前記式(3a) 及び(3b)から選択された少なくとも1種の(メタ)ア クリル酸エステルを22~58モル%含む単量体混合物 を共重合することにより得ることができる。

【0024】式(1)で表される化合物には、5-アク リロイルオキシー2, 6-ノルボルナンカルボラクトン (=4-アクリロイルオキシ-6-オキサトリシクロ $[3.2.1.1^{3.8}]$ $(2.2.1.1^{3.8}]$ クリロイルオキシー2,6-ノルボルナンカルボラクト ン(=4-メタクリロイルオキシ-6-オキサトリシク ロ[3.2.1.13.8] ノナン-7-オン) が含まれ る。これらのモノマーは単独で又は2種を組み合わせて 使用できる。

【0025】式(2)で表される化合物には、1-アク リロイルオキシー3ーヒドロキシアダマンタン、1ーメ タクリロイルオキシー3-ヒドロキシアダマンタンが含 まれる。これらのモノマーは単独で又は2種を組み合わ せて使用できる。

【0026】式(3a)で表される代表的な化合物として は、例えば、1-(2-アクリロイルオキシ-2-プロ ピル) アダマンタン [=1-(1-アクリロイルオキシ **-1-メチルエチル)アダマンタン**]、1-(2-メタ リロイルオキシー2ープロピル)アダマンタン[=1-(1-メタクリロイルオキシ-1-メチルエチル)アダ マンタン]、1-(1-アクリロイルオキシ-1-メチ ルプロピル)アダマンタン、1-(1-メタクリロイル オキシー1-メチルプロピル)アダマンタン、1-(1 -アクリロイルオキシ-1-エチルプロピル)アダマン 50 ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素;シクロヘキ

、 タン、1-(1-メタクリロイルオキシ-1-エチルプ ロピル) アダマンタン、1-(1-アクリロイルオキシ -1-メチルブチル)アダマンタン、1-(1-メタク リロイルオキシー1-メチルブチル) アダマンタンなど が挙げられる。これらのモノマーは単独で又は2種以上 組み合わせて使用できる。

【0027】式(3b)で表される化合物には、2-アク リロイルオキシー2 -メチルアダマンタン、2-メタク リロイルオキシー2 -メチルアダマンタン、2-アクリ 2-メタクリロイルオキシアダマンタンが含まれる。 こ れらのモノマーは単独で又は2種以上組み合わせて使用 できる。

【0028】重合は、溶液重合、溶融重合など、アクリ ル系ポリマーを製造する際に用いる慣用の方法により行 うことができる。重合溶媒としては公知の溶媒を使用で き、例えば、エーテル(ジエチルエーテル等の鎖状エー テル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の環状エーテ ルなど)、エステル(酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブ チル、乳酸エチルなど)、ケトン(アセトン、メチルエ チルケトン、メチルイソブチルケトンなど)、アミド (N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホ ルムアミドなど)、スルホキシド(ジメチルスルホキシ ドなど)、アルコール(メタノール、エタノール、プロ パノールなど)、炭化水素(ベンゼン、トルエン、キシ レン等の芳香族炭化水素、ヘキサン等の脂肪族炭化水 素、シクロヘキサン等の脂環式炭化水素など)、これら の混合溶媒などが挙げられる。また、重合開始剤として 公知の重合開始剤を使用できる。重合温度は、例えば3 30 0~150℃程度の範囲で適宜選択できる。

【0029】本発明のフォトレジスト用高分子化合物 は、好ましくは、前記(a)、(b)及び(c)の3種 の(メタ)アクリル酸エステルを含む単量体混合物を共 重合し、生成したポリマーを含む溶液(例えば、前記重 合溶媒の溶液)を有機溶媒中に添加することにより沈殿 又は再沈殿して得られるフォトレジスト用高分子化合物 である。このようなフォトレジスト用高分子化合物で は、モノマーや、オリゴマー等の低分子量物が沈殿及び /又は再沈殿操作の際に有機溶媒に溶解して容易に除去 されるため、フォトレジスト用樹脂として用いた場合 に、微細なパターンを精度よく形成することができる。 なお、沈殿又は再沈殿操作の際に水を沈殿又は再沈殿溶 媒として用いた場合には、前記低分子量物は水に溶解し にくいため十分に除去することができない。そのため、 得られた高分子化合物をフォトレジスト用樹脂として用 いた際、微細なバターンを精度よく形成することができ ないことがある。

【0030】前記沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機 溶媒として、例えば、炭化水素(ペンタン、ヘキサン、

サン、メチルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素; べ ンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素)、 ハロゲン化炭化水素(塩化メチレン、クロロホルム、四 塩化炭素などのハロゲン化脂肪族炭化水素;クロロベン ゼン、ジクロロベンゼンなどのハロゲン化芳香族炭化水 素など)、ニトロ化合物(ニトロメタン、ニトロエタン など)、ニトリル(アセトニトリル、ベンゾニトリルな ど)、エーテル(ジエチルエーテル、ジイソプロピルエ ーテル、ジメトキシエタンなどの鎖状エーテル;テトラ ヒドロフラン、ジオキサンなどの環状エーテル)、ケト 10 剤とを少なくとも含んでいる。 ン(アセトン、メチルエチルケトン、ジイソブチルケト ンなど)、エステル(酢酸エチル、酢酸ブチルなど)、 カーボネート(ジメチルカーボネート、ジエチルカーボ ネート、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネー トなど)、アルコール(メタノール、エタノール、プロ パノール、イソプロピルアルコール、ブタノールな ど)、カルボン酸(酢酸など)、これらの溶媒を含む混 合溶媒等が挙げられる。

【0031】中でも、前記沈殿又は再沈殿溶媒として用 いる有機溶媒として、少なくとも炭化水素(特に、ヘキ 20 サンなどの脂肪族炭化水素)を含む溶媒が好ましい。こ のような少なくとも炭化水素を含む溶媒において、炭化 水素(例えば、ヘキサンなどの脂肪族炭化水素)と他の 溶媒との比率は、例えば前者/後者(体積比;25℃) = 10/90~99/1、好ましくは前者/後者(体積 比;25℃)=30/70~98/2、さらに好ましく は前者/後者(体積比;25℃)=50/50~97/ 3程度である。

【0032】前記沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機 溶媒のFedorsの方法による溶解度パラメーター (以下、単に「SP値」と称することがある)の値は、 7. $0 (cal/cm^3)^{1/2} \sim 14.0 (cal/cm$ ³) ¹/² [14. 3MPa¹/²~28. 6MPa¹/²] の範 囲であるのが好ましい。このような有機溶媒を沈殿又は 再沈殿溶媒として用いると、フォトレジスト用樹脂とし て特に好適な組成分布を有する高分子化合物を得ること ができる。

【0033】前記有機溶媒のSP値は、例えば、「ポリ マーハンドブック (Polymer Handbook) 」、第4版、VI I-675頁~VII-711頁に記載の方法により求めることがで 40 きる。また、前記有機溶媒のSP値として、該文献の表 1(VII-683頁)、表7~8(VII-688頁~VII-711頁) の値を採用できる。前記有機溶媒が複数の溶媒の混合溶 媒である場合のSP値は、公知の方法により求めること ができる。例えば、混合溶媒のSP値は、加成性が成立 するとして、各溶媒のSP値と体積分率との積の総和と して求めることができる。

【0034】前記有機溶媒のSP値は、より好ましくは 7. 0 $(cal/cm^3)^{1/2} \sim 9$. 0 (cal/c m^3) 1/2 [14. 3MPa^{1/2}~18. 4MPa^{1/2}].

及び12.0 (cal/cm³) 1/2~14.0 (cal $/cm^3$) 1/2 [24. 5MPa1/2~28. 6MP a¹/²] の範囲であり、特に好ましくは7.5 (cal $/cm^3$) $^{1/2}\sim 8.5$ (cal/cm³) $^{1/2}$ [15.3] MPa^{1/2}~17. 4MPa^{1/2}]、及び13.0(ca $1/cm^3$) $1/2 \sim 14.0 (cal/cm^3) 1/2 [2]$ 6. 6MPa¹/²~28. 6MPa¹/²]の範囲である。 【0035】本発明のフォトレジスト用樹脂組成物は、 前記本発明のフォトレジスト用高分子化合物と光酸発生

【0036】光酸発生剤としては、露光により効率よく 酸を生成する慣用乃至公知の化合物、例えば、ジアゾニ ウム塩、ヨードニウム塩(例えば、ジフェニルヨードへ キサフルオロホスフェートなど)、スルホニウム塩(例 えば、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチ モネート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホ スフェート、トリフェニルスルホニウムメタンスルホネ ートなど)、スルホン酸エステル [例えば、1 – フェニ ル-1-(4-メチルフェニル)スルホニルオキシ-1 **-ベンゾイルメタン、1,2,3-トリスルホニルオキ** シメチルベンゼン、1、3-ジニトロー2-(4-フェ ニルスルホニルオキシメチル) ベンゼン、1-フェニル -1-(4-メチルフェニルスルホニルオキシメチル) -1-ヒドロキシー1-ベンゾイルメタンなど]、オキ サチアゾール誘導体、 s - トリアジン誘導体、ジスルホ ン誘導体(ジフェニルジスルホンなど)、イミド化合 物、オキシムスルホネート、ジアゾナフトキノン、ベン ゾイントシレートなどを使用できる。これらの光酸発生 剤は単独で又は2種以上組み合わせて使用できる。

【0037】光酸発生剤の使用量は、光照射により生成 する酸の強度や前記高分子化合物における各モノマー単 位の比率などに応じて適宜選択でき、例えば、前記高分 子化合物100重量部に対して0.1~30重量部、好 ましくは1~25重量部、さらに好ましくは2~20重 量部程度の範囲から選択できる。

【0038】フォトレジスト用樹脂組成物は、アルカリ 可溶性樹脂(例えば、ノボラック樹脂、フェノール樹 脂、イミド樹脂、カルボキシル基含有樹脂など)などの アルカリ可溶成分、着色剤(例えば、染料など)、有機 溶媒(例えば、炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、ア ルコール類、エステル類、アミド類、ケトン類、エーテ ル類、セロソルブ類、カルビトール類、グリコールエー テルエステル類、これらの混合溶媒など)などを含んで いてもよい。

【0039】とのフォトレジスト用樹脂組成物を基材又 は基板上に塗布し、乾燥した後、所定のマスクを介し て、塗膜(レジスト膜)に光線を露光して(又は、さら に露光後ベークを行い)潜像パターンを形成し、次いで 現像することにより、微細なバターンを高い精度で形成 50 できる。

【0040】基材又は基板としては、シリコンウエハ、金属、プラスチック、ガラス、セラミックなどが挙げられる。フォトレジスト用樹脂組成物の塗布は、スピンコータ、ディップコータ、ローラコータなどの慣用の塗布手段を用いて行うことができる。塗膜の厚みは、例えば $0.1\sim20\,\mu\,\mathrm{m}$ 、好ましくは $0.3\sim2\,\mu\,\mathrm{m}$ 程度である。

【0041】露光には、種々の波長の光線、例えば、紫外線、X線などが利用でき、半導体レジスト用では、通常、g線、i線、エキシマレーザー(例えば、XeCl、KrF、KrCl、ArF、ArClなど)などが使用される。露光エネルギーは、例えば1~1000mJ/cm²、好ましくは10~500mJ/cm²程度である。

【0042】光照射により光酸発生剤から酸が生成し、 この酸により、例えば前記高分子化合物のアルカリ可溶 性ユニットのカルボキシル基等の保護基(脱離性基)が 速やかに脱離して、可溶化に寄与するカルボキシル基等 が生成する。そのため、水又はアルカリ現像液による現 像により、所定のパターンを精度よく形成できる。 【0043】

【発明の効果】本発明によれば、脂環式骨格を有する特定構造の3種のモノマーユニットを特定の割合で含んでいるため、高いドライエッチング耐性、基板密着性及びアルカリ可溶性を示すだけでなく、レジスト用溶剤として好適なプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)に対して高い溶解性を示す。そのため、フォトレジスト用樹脂として好適である。また、微細なパターンを高い精度で形成することができる。

【0044】また、本発明のフォトレジスト用高分子化 30 合物は、ポリマーを構成するモノマーユニットの全部又は大部分が脂環式骨格を有するモノマーユニットであっても、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート (PGMEA) に対して高い溶解性を示す。

[0045]

【実施例】以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細 に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定 されるものではない。なお、構造式中の括弧の右下の数 字は該モノマーユニットのモル%を示す。

【0046】実施例1 下記構造の樹脂の合成

[化5]

還流管、攪拌子、3方コックを備えた100ml丸底フ

ラスコに、5-メタクリロイルオキシ-2,6-ノルボ ルナンカルボラクトン1.38g(6.22ミリモ ル)、1-(2-メタクリロイルオキシ-2-プロビ ル)アダマンタン2.16g(8.24ミリモル)、1 ーメタクリロイルオキシー3-ヒドロキシアダマンタン 1. 46g(6.19ミリモル)、及び開始剤(和光純 薬工業製V-65)0.50gを入れ、THF(テトラ ヒドロフラン)16.00gに溶解させた。続いて、フ ラスコ内を乾燥窒素置換した後、反応系の温度を60℃ 10 に保ち、窒素雰囲気下、6時間攪拌した。反応液をヘキ サンと酢酸エチルの9:1(体積比;25℃)混合液 [SP値: 7. 65 (cal/cm³) 1/2 (= 15. 6 4MPa¹/²)] 500ml に落とし、生じた沈殿物を **瀘別することで精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥** 後、再度THF16.00gに溶解させ、上述の沈殿精 製操作を繰り返すことにより、所望の樹脂3.55gを 得た。回収したポリマーをGPC分析したところ、Mw (重量平均分子量)が7800、分子量分布(Mw/M n)が2.15であった。1H-NMR (DMSO-d。 20 中)分析では、1.5-2.5ppm (ブロード) のほ か、3. 1 ppm、4. 6 ppm、4. 7 ppmに強い シグナルが観測された。

【0047】比較例1 下記構造の樹脂の合成 【化6】

還流管、攪拌子、3方コックを備えた100m1丸底フ ラスコに、5-メタクリロイルオキシ-2,6-ノルボ ルナンカルボラクトン2.06g(9.28ミリモ ル)、1-(2-メタクリロイルオキシ-2-プロビ ル) アダマンタン1.54g(5.88ミリモル)、1 -メタクリロイルオキシ-3-ヒドロキシアダマンタン 0.40g(1.69ミリモル)、及び開始剤(和光純 40 薬工業製V-65) O. 40gを入れ、THF (テトラ ヒドロフラン) 16.00gに溶解させた。続いて、フ ラスコ内を乾燥窒素置換した後、反応系の温度を60℃ に保ち、窒素雰囲気下、6時間撹拌した。反応液をヘキ サンと酢酸エチルの9:1 (体積比;25℃)混合液5 00mlに落とし、生じた沈殿物を濾別することで精製 を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再度THF1 6.00gに溶解させ、上述の沈殿精製操作を繰り返す ことにより、所望の樹脂3.22gを得た。回収したボ リマーをGPC分析したところ、Mw(重量平均分子) 50 量) が7600、分子量分布(Mw/Mn) が2.00

14

であった。¹H-NMR (DMSO-d₅中) 分析では、 1.5-2.5ppm (ブロード) のほか、3.1pp m、4.6ppm、4.7ppmに強いシグナルが観測 された。

13

【0048】比較例2 下記構造の樹脂の合成 【化7】

還流管、攪拌子、3方コックを備えた100ml丸底フラスコに、5-メタクリロイルオキシ-2,6-ノルボルナンカルボラクトン0.91g(4.10ミリモル)、1-(2-メタクリロイルオキシ-2-プロピル)アダマンタン2.15g(8.21ミリモル)、1-メタクリロイルオキシ-3-ヒドロキシアダマンタン1.94g(8.22ミリモル)、及び開始剤(和光純薬工業製V-65)0.50gを入れ、THF(テトラヒドロフラン)16.00gに溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1(体積比;25℃)混合液500mlに落とし、生じた沈殿物を濾別することで精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再度THF1

6.00gに溶解させ、上述の沈殿精製操作を繰り返す ことにより、所望の樹脂3.41gを得た。回収したポリマーをGPC分析したところ、Mw(重量平均分子 量)が8000、分子量分布(Mw/Mn)が2.08 であった。¹H-NMR(DMSO-d。中)分析では、 1.5-2.5ppm(ブロード)のほか、3.1pp m、4.6ppm、4.7ppmに強いシグナルが観測 された。

【0049】評価試験

10 上記実施例及び比較例で得られたポリマーのそれぞれに ついて、ボリマー100重量部とトリフェニルスルホニ ウムヘキサフルオロアンチモネート10重量部とをプロ ピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PG MEA) と混合して、ポリマー濃度17重量%のフォト レジスト用樹脂組成物を調製した。しかし、比較例で得 られたポリマーはPGMEAに溶解せず、露光評価に付 すことができなかった。実施例で得られたポリマーを使 用して調製したフォトレジスト用樹脂組成物をシリコン ウエハーにスピンコーティング法により塗布し、厚み 1. Ομmの感光層を形成した。ホットプレート上で温 度100℃で150秒間プリベークした後、波長247 nmのKrFエキシマレーザーを用い、マスクを介し て、照射量30mJ/cm²で露光した後、100℃の 温度で60秒間ポストベークした。次いで、0.3Mの テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により6 O秒間現像し、純水でリンスしたところ、 O. 2 O μ m のライン・アンド・スペースパターンが得られた。